


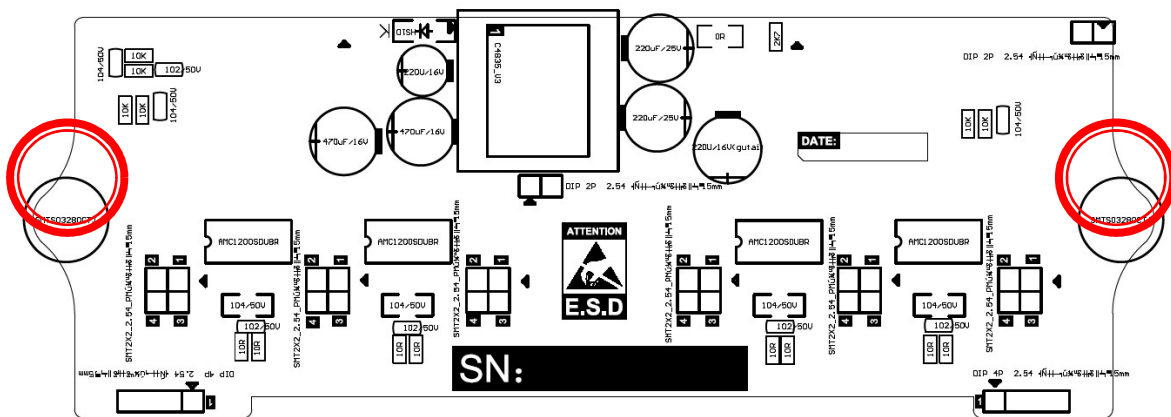
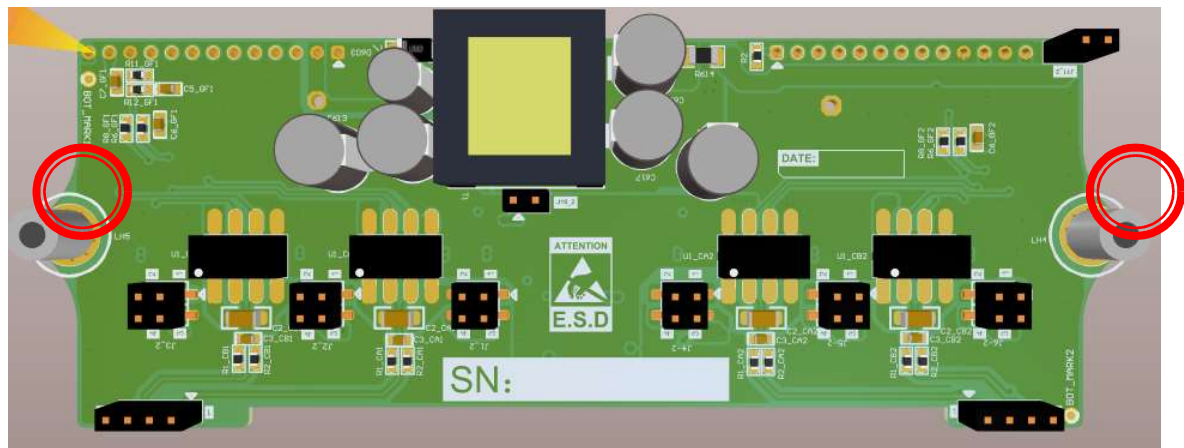
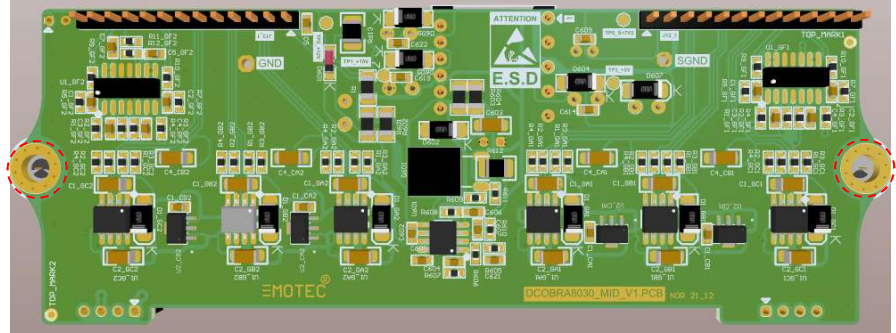
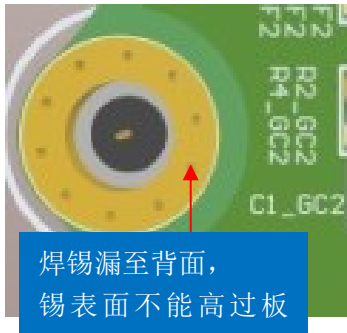
PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	DCOBRA4842_MID_V1	焊接	QM0332021122002	V1	1/1	20211220

1) 贴片螺母焊接要求:

- a) LH4~LH5 位置焊接 SMTS03280CTJ ( M3\*8 不带螺纹支撑柱) 
- b) 贴片螺母要求落到底焊接, 保证焊接后螺母垂直于 PCB;
- c) 贴片螺母的焊盘圆周上的过孔注满锡, 焊锡与圆柱体形成锥面 (见右图);
- d) 贴片螺母的顶端不能有沾锡;



※贴片螺母焊接位置的背面 (即顶层), 焊锡漏至背面, 锡表面不能高过板面



- 2) 有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 3) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 4) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 5) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 6) 手工操作要做防静电处理;
- 7) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;
- 8) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	